

证券代码：688120

证券简称：华海清科

华海清科股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-04

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 分析师会议 ☒ 业绩说明会 ☐ 路演活动 ☐ 其他
参与单位名称	详见附件
时间	2025年11月4日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理王同庆 董事、财务总监王怀需 董事会秘书陈圳寅
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司董事会秘书介绍公司经营业绩主要情况： 2025 年第三季度，公司持续加大研发投入和生产能力建设，平台化发展战略扎实推进，新品类产品多点突破。公司首台 12 英寸低温离子注入机 iPUMA-LT 顺利出机；12 英寸晶圆边缘修整装备 Versatile-DT300 实现批量出货；战略投资苏州博宏源，构建精密平面化装备一站式平台；广州厂区正式启用，战略布局核心零部件业务领域等。2025 年前三季度，公司实现营业收入 31.94 亿元，同比增长 30.28%；实现归母净利润 7.91 亿元，同比增长 9.81%；实现归母扣非净利润 7.23 亿元，同比增长 17.61%。 二、问答环节 Q1：请介绍下公司前三季度收入具体情况 A：2025 年前三季度，公司经营业绩保持高增长态势，实现营业收入 31.94 亿元，同比增长 30.28%，增长动能强劲。收入结构方面，CMP 装备作为核心业务持续贡献主要收入；同时磨划

	装备、晶圆再生及耗材维保等业务收入实现较大比例增长，收入占比显著提升，成为营收增长的重要补充，充分体现了公司“装备+服务”平台化布局的持续落地，多元业务矩阵持续完善，为公司长期稳健发展奠定了坚实基础。 Q2: 第三季度公司的毛利率与净利率均出现下滑，请问是什么原因导致？ A: 公司第三季度确认收入的部分产品处于市场开拓阶段，毛利率较低，导致第三季度毛利率环比下降；同时公司围绕长期发展战略，持续加码研发投入与生产能力建设，稳步推进人员扩充，使得职工薪酬增加并推高期间费用，导致净利率呈现阶段性下滑，但公司核心产品的技术优势、市场竞争力以及下游长期需求趋势均未发生改变，后续公司将通过持续开发新客户新产品、改进工艺提升效率、降本增效等管理措施保持公司毛利率及净利率在一个相对合理的水平。 Q3: 公司 2025 年前三季度研发费用增速较为明显，请问公司研发投入将围绕哪些方面展开，研发费用率预计有何变动？ A: 公司将围绕现有产品布局持续加大研发投入，确保研发费用合理增长，以技术创新驱动业务持续拓展。结合市场需求与行业技术发展趋势，公司研发工作将聚焦核心方向、多点协同推进：一是迭代升级 CMP 装备，一方面推出适配碳化硅等多种材质工艺及更先进制程的产品，另一方面针对性开发满足 HBM 等先进封装新需求的机型；二是加大新产品研发投入，积极开发更高 WPH、更高 TTV 的减薄机型，逐步加大对划切装备、边抛装备、湿法装备的研发资源投入；三是加速离子注入技术突破，深化核心技术的吸收与转化，稳步推进多品类离子注入装备的开发与验证，进一步巩固并提升公司在核心半导体装备领域的综合竞争优势。 Q4: 公司 2025 年三季度末合同负债较 2024 年末有所下降，请问主要原因是什么？
--	---

	A: 公司 2025 年三季度末合同负债金额较 2024 年末有所下降，一方面是由于公司确认收入后需要冲减一部分合同负债，另一方面是由于不同客户的付款节奏要求不同，部分客户更注重到货付款比例，因此公司适当对部分客户预付款比例进行了调整，合同负债变动处于正常区间。 Q5: 请介绍下公司订单情况 A: 公司 CMP 装备订单持续保持增长，减薄装备、离子注入装备、湿法装备、晶圆再生及耗材维保等订单放量明显，划切及边抛装备也取得多家客户订单，公司平台化布局扎实稳步推进；从订单客户结构来看，存储及逻辑订单占比较大，先进封装订单占比提升明显。公司目前在手订单充足，也将积极跟进客户的扩产计划，争取更多订单和市场份额。 Q6: 请介绍下 HBM 等先进封装需求对公司未来发展的影响 A: 随着国内 AI 技术在算法架构、算力密度等核心维度的持续突破，公司主打产品 CMP 装备、减薄装备、划切装备、边抛装备作为芯片堆叠与先进封装技术实现高密度集成、高可靠性运行的关键核心装备，将获得更加广泛的应用，为公司持续高速增长提供强劲动能。 Q7: 请介绍下公司晶圆再生业务情况 A: 公司积极拓展晶圆再生业务，已成为具备 Fab 装备及工艺技术服务的晶圆再生专业代工厂，凭借核心技术优势与稳定的服务质量，公司已斩获多家大型生产线的批量订单，并实现长期稳定供货；天津基地 20 万片/月的产能当前已处于满产运行状态，业务规模与市场认可度持续提升。同时，为有效抢抓晶圆厂加速扩产的窗口期，扩大先发优势和规模效应，公司拟在昆山建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为 40 万片/月，其中首期建设产能为 20 万片/月，进一步扩大晶圆再生加工能力以便更好地响应客户的需求。 Q8: 请介绍下公司装备产品产能扩张情况
--	---

	A: 随着集成电路发展成为国家重点战略和全球贸易环境的日趋复杂，半导体专用装备的国产化需求愈发迫切且增长迅速，公司加快产能规划及产业布局。华海清科北京子公司实施的“华海清科集成电路高端装备研发及产业化项目”和天津二期项目均已完工，将逐步释放产能。同时公司将加速推进“上海集成电路装备研发制造基地项目”建设，持续完善区位布局，提高公司的辐射范围，充分把握半导体装备市场发展机遇，进一步扩大公司生产经营规模。 Q9: 请介绍一下芯崙公司的经营情况 A: 公司全资子公司芯崙公司主要从事集成电路离子注入设备的研发、生产和销售。离子注入机作为半导体制造核心装备，其中大束流类型的份额占比最高，基于对市场需求的精准判断，公司将大束流离子注入机作为核心突破点，持续加大研发投入。今年自主研发的首台 12 英寸低温离子注入机 iPUMA-LT 发往国内逻辑芯片制造领域龙头企业，成功实现面向芯片制造的大束流离子注入机各型号的全覆盖；最新一代大束流离子注入机在置换率等方面已与国际领先竞争对手达到同一水平，具备高稳定性与高工艺匹配度，能够满足先进制程对离子注入均匀性、精准度的严苛要求。同时公司正积极布局高能、碳化硅等多品类离子注入装备，以满足逻辑芯片、存储芯片、功率半导体、CIS（图像传感器）以及硅片制造等应用领域对高质量、大规模制造的严苛需求，争取更多订单和市场份额。
附件清单	参会机构清单
日期	2025 年 11 月 5 日

附件：参会机构清单（排名不分先后）

序号	机构名称
1	Foundation Asset Management (HK) Limited
2	博时基金管理有限公司
3	财通证券资产管理有限公司
4	财信证券有限责任公司
5	创金合信基金管理有限公司
6	德邦基金管理有限公司
7	东方阿尔法基金管理有限公司
8	东兴基金管理有限公司
9	东亚前海
10	高盛
11	歌汝私募
12	工银瑞信基金管理有限公司
13	光大证券股份有限公司自营
14	广东海辉华盛证券投资基金管理有限公司
15	广东银石私募基金管理有限公司
16	广东正圆私募基金管理有限公司
17	广发证券股份有限公司
18	国融证券股份有限公司
19	国寿安保基金管理有限公司
20	杭州萧山泽泉投资管理有限公司
21	合众资产管理股份有限公司
22	红土创新管理有限公司
23	宏利基金管理有限公司
24	湖南源乘私募基金管理有限公司
25	华宝基金管理有限公司
26	华泰保兴基金管理有限公司
27	华西证券
28	汇百川
29	汇丰晋信基金管理有限公司
30	汇添富基金管理股份有限公司
31	九泰基金管理有限公司
32	路博迈基金管理(中国)有限公司
33	南方天辰(北京)投资管理有限公司
34	群益证券投资信托股份有限公司
35	仁桥（北京）资产管理有限公司
36	沙钢集团投资控股有限公司
37	上海晨燕资产管理中心（有限合伙）
38	上海东方证券资产管理有限公司
39	上海光大证券资产管理有限公司
40	上海海通证券资产管理有限公司
41	上海合道资产管理有限公司

42	上海金锝私募基金管理有限公司
43	上海明河投资管理有限公司
44	上海盘京投资管理中心（有限合伙）
45	上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙）
46	上海远海私募基金管理有限公司
47	申万宏源证券有限公司
48	申万菱信基金管理有限公司
49	深圳聚沅资本管理有限公司
50	深圳猎投资本合伙企业(有限合伙)
51	深圳市榕树投资管理有限公司
52	深圳熙山资本管理有限公司
53	太平资产管理有限公司
54	泰信基金管理有限公司
55	天风(上海)证券资产管理有限公司
56	天风证券股份有限公司
57	天弘基金管理有限公司
58	同泰基金管理有限公司
59	闻天私募证券投资基金管理（广州）有限公司
60	西部利得基金管理有限公司
61	新华基金管理股份有限公司
62	兴业资管（自营）
63	旭松资本管理有限公司
64	银河基金管理有限公司
65	银华基金管理股份有限公司
66	长城财富保险资产管理股份有限公司
67	长江证券（上海）资产管理有限公司
68	招商证券资产管理有限公司
69	浙商电子
70	浙商基金管理有限公司
71	中国国际金融股份有限公司资产管理部
72	中国银河证券股份有限公司
73	中航基金管理有限公司
74	中金电子
75	中泰证券
76	中信保诚基金管理有限公司
77	中信期货有限公司
78	中信证券
79	中银基金管理有限公司